股票代號 **7828**

INNOS®
創新服務股份有限公司

創新服務(股)公司

115年第三季 營運概況及未來展望

2026/11

免責聲明

- 本公司基於簡報當時之主客觀因素，對過去、現在及未來之營運進行彙總與評估；其中含有前瞻性之論述，將受風險、不確定性及推論等所影響，容有超出本公司得以控制之部分，致實際情況或結果可能與上揭前瞻性論述大相逕庭。
- 本簡報所提供之資訊（包含但不限於對未來之看法），並未明示或暗示地表達或保證其具有正確性、完整性及可靠性，亦不代表本公司、產業狀況及後續重大發展之完整論述。
- 本簡報中對未來之展望，僅反應本公司截至發表時點之看法；嗣後若有任何變更或調整，本公司不負提 醒及更新之責任。
- 本簡報及其內容非經本公司事前書面同意，任何第三人不得逕行援用或擷取之。

© Innostar Service Inc. Confidential & Proprietary.

目錄

1. 公司簡介及經營理念
2. 產業及營運概況
3. 115年Q3實績及未來展望

INNOS®
創新服務股份有限公司

股票代號 7828

1.公司簡介及經營理念

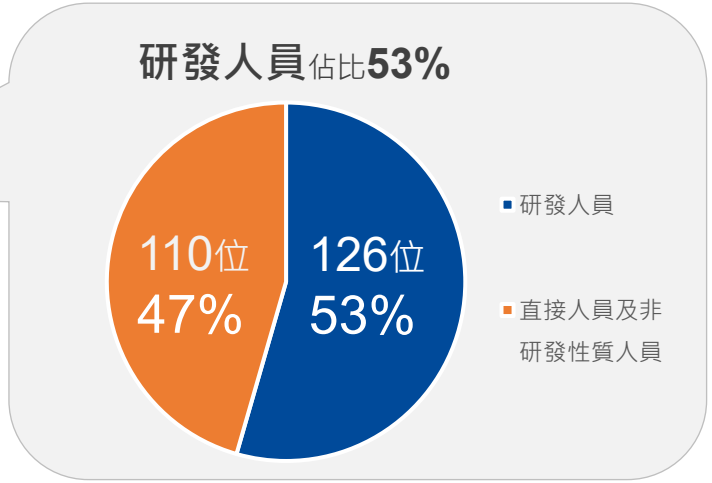
創新服務為您的製程創新、產品創新，

提供最專業整體解決方案。

公司簡介

創新服務股份有限公司
InnoStar Service, Inc.

- 創新服務成立於 2004 年
- 實收資本額：新台幣4.05億元
- 員工數： 236人
  （截至115/10）
- 服務據點
  - 新竹廠
  - 台中總廠(興安廠，中山廠)
  - 高雄辦公室
- 營業項目
  - 半導體自動化設備開發、製造及銷售業務。
  - 先進封裝解決方案。
  - 先進封裝製程元件、製造及銷售業務。
  - 探針卡維修與材料服務與銷售業務。





© Innostar Service Inc. Confidential & Proprietary.

公司里程碑

2004
- 公司成立
- 推出第一代塑膠剪切機。
- **開啟光學產業自動化革命**

2014
- 切入半導體先進測試製程，開發半導體晶圓級測試MEMS探針卡自動植針設備
- **開啟探針卡植針自動化革命**

2016
- 取得半導體晶圓國際大廠MEMS探針植針代工業務，已累積超過3億根針經驗。
- 自動化植針設備獲得主要探針卡大廠採用

2022
- 高密度銅柱端子模組，應用於WIFI模組大量送樣。
- 探針卡廠大量採用植針設備。



2024
- 高密度銅柱端子模組，應用於Power Module, TGV, PLP模組。
- TP成為策略投資人
- 推出MEMS探針卡Probe Card整體自動化維修解決方案



2025
- **高密度銅柱端子模組邁入量產**
- **2026/4/22上櫃掛牌**

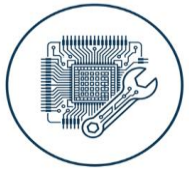
2026
- **MEMS探針卡Probe Card系列設備機台開發11台**
- **Probe Card自動化維修產建置完成**

© Innostar Service Inc. Confidential & Proprietary.



2. 產業及營運概況

創新服務-營運成長「三引擎」



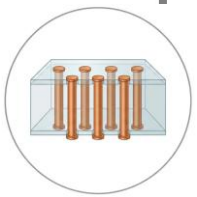
半導體MEMS探針卡自動化設備-2027倍數成長

- 雙ARM植針機以及維修repair設備未來出貨將呈正向大幅成長
- 自動植針機以外之返修設備預計2027 Q2開始大量出貨



探針卡材料包與返修代工-2027 擴大產出

- 協助TP擴展探針卡業務: 搶攻ASIC新客戶群
- 2027 年Q1擴大建置完整探針卡維修產線,擴大探針卡維修業務



銅柱模組與 TGV-營運力道2028 Q4展現

- 2026底陸續接獲Cu Pillar Module 訂單, 銅柱模組開始正式量產:應用於Power模組,穿戴式耳機通訊模組等
- 2028年底目標量產TGV-ICP核心玻璃基板產品, 應用於AI晶片ABF封裝載板

© Innostar Service Inc. Confidential & Proprietary.

2026創新三引擎產品線

股票代號 **7828**

#		MEMS探針卡相關業務 產品名稱	客戶群	2026 Q1	Q2	Q3	Q4
1.	探針卡 自動化設備	1. 1st wave-雙Arm植針機	探針卡廠				
		2. 2nd wave -探針卡返修機系列: 換針機,塑針機,檢查機,雷射清潔機,分選及整列機,雷射塑針機,自動調針機	探針卡廠				
		3. 3rd wave-探針卡自動化分析儀,自動化整形機.....	探針卡廠				2027出貨
	AI晶片載板 修復設備	4. ABF載板自動化檢測機,雷射返修機	載板廠				測試驗證
2.	材料包 及代工	1 探針卡代工: 植針/塑針/ 分類&量測&排針	探針卡廠				持續代工
		2. 探針卡材料包銷售	探針卡廠				DOE卡出貨
3.	銅柱 產品	1. 銅柱模組: AiP, Power Module	OSAT廠 天線模組廠 電源IC廠				2026年底邁入量產
		2. TVG-ICP (Cu pillar inserted) core layer substrate	晶片 公司				NTI 新技術驗證

© Innostar Service Inc. Confidential & Proprietary.

1.MEMS 探針卡生產: 全線自動化設備已開發11台,3台開發中,共計14台先進設備

Manufacturing / Inspection / Repair / Analysis Full Line Solution





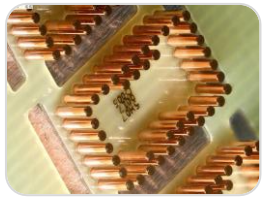
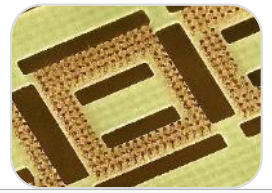








3.高密度銅柱TGV及模組產品

客戶群	客戶	導入階段
TGV 高速傳輸模組   	2大IC客戶	• **2028 Q3之後量產**
AI Power Module   	OSAT Power元件廠	• **2027 量產**
RF / 網通等   	歐系電子產品廠 天線模組廠	• **2027 量產**

© Innostar Service Inc. Confidential & Proprietary.

INNOS®
創新服務股份有限公司

股票代號 **7828**

3.115Q3實績及未來展望

經營實績

單位：新台幣千元

	2026年9月30日	2025年12月31日
現金及約當現金	952,746	413,366
按攤銷後成本衡量之金融資產 - 流動	2,972,600	294,930
應收帳款淨額	534,549	321,460
存貨	602,737	211,002
不動產、廠房及設備	1,390,900	404,539
資產總計	**6,596,440**	**1,742,594**
合約負債 - 流動	639,267	79,033
應付帳款	347,026	103,598
長期借款	0	171,291
負債總計	**1,247,220**	**550,679**
普通股股本	405,319	366,859
權益總計	**5,349,220**	**1,191,915**
每股淨值	**131.98**	**32.49**

- 1.約當現金及定存合計39.25億元
- 2.負債比率僅19%，無銀行借款。
- 3.存貨金額大幅增加，主係為備料所致；存貨金額 79%集中於原料、在製品。
- 4.合約負債截至9月底6.39億元。

© Innostar Service Inc. Confidential & Proprietary.

經營實績

單位：新台幣千元

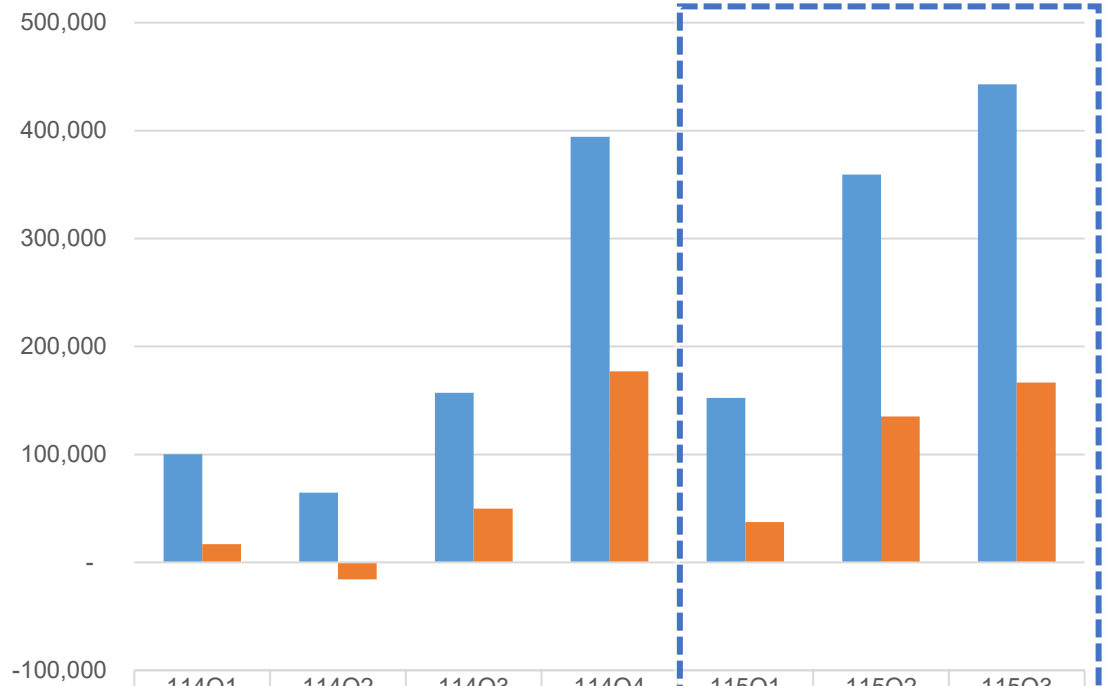
	2026/7/1~9/30		2026上半年		2025年度	
營業收入	**442,825**		**511,463**		**716,233**	
營業成本	95,175		105,141		170,092	
營業毛利	**347,650**	**79%**	**406,322**	**80%**	**546,141**	**76%**
推銷費用	8,481	2%	18,950	4%	21,734	**3%**
管理費用	49,396	11%	69,960	14%	90,824	13%
研究發展費用	72,302	16%	115,496	22%	154,341	21%
預期信用減損損失（利益）	10,606		455		917	
營業利益	**206,865**	**47%**	**201,461**	**39%**	**278,325**	**39%**
本期淨利	166,683	38%	172,564	34%	227,671	32%
基本每股盈餘	4.12		4.52		6.33	
EBITDA Margin	49%		46%		43%	

1. 毛利率/營業利益率/淨利率/EBITDA Margin維持好表現。
2. 持續投入研發，隨營收擴大，費用率下降。

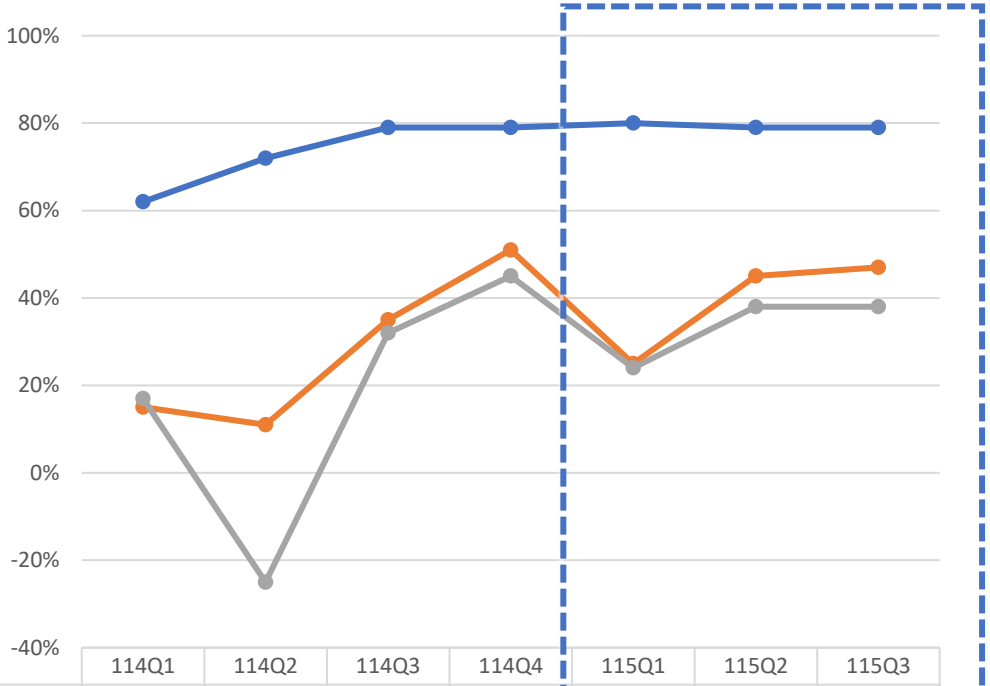
© Innostar Service Inc. Confidential & Proprietary.

經營實績

單位：NTD 仟元



	114Q1	114Q2	114Q3	114Q4	115Q1	115Q2	115Q3
營業收入	100,286	64,555	157,023	394,369	152,278	359,185	442,825
稅後淨利	16,863	(15,866)	49,749	176,925	37,306	135,258	166,683



	114Q1	114Q2	114Q3	114Q4	115Q1	115Q2	115Q3
毛利率	62%	72%	79%	79%	80%	79%	79%
營業利益率	15%	11%	35%	51%	25%	45%	47%
淨利率	17%	-25%	32%	45%	24%	38%	38%

© Innostar Service Inc. Confidential & Proprietary.

生產廠區

竹北廠：員工27人



1. 租賃廠區。建物面積：1,323平方公尺
2. 植針代工及維修。設備/人員/場地皆已 ready。

興安1廠：員工145人



1. 自有資產。建物面積：3,945平方公尺
2. 設備組裝產線+銅柱模組（年產能10,000,000PCS)+TGV-ICP（年產能規劃120,000片）

與安2廠：2027年第二季底完工



1. 規劃建物面積：3,641平方公尺
2. TGV-ICP (年產能規劃300,000片）

中山廠：員工58人



1. 自有資產。土地：5,660平方公尺
2. 建物面積：12,502平方公尺
3. 設備組裝產線+ 探針卡自動化維修產線+TGV-ICP (配合客戶進程佈產線設備，年產能規劃1,680,000片）

義和段：2026/11/10董事會通過購入土地

1. 土地面積：8,598平方公尺
2. 尚未過戶，規劃中。



© Innostar Service Inc. Confidential & Proprietary.

未來展望-營運成長「三引擎」

半導體MEMS探針卡自動化設備

- 雙ARM植針機受惠終端客群成長力道加強，未來出貨將呈正向大幅成長。
- 探針卡維修自動化相關設備陸續驗證完成出貨，將於2027年帶來新一波成長力道。
- 新一波探針卡相關先進設備已進行開發， 預期於2027年挹注營收。

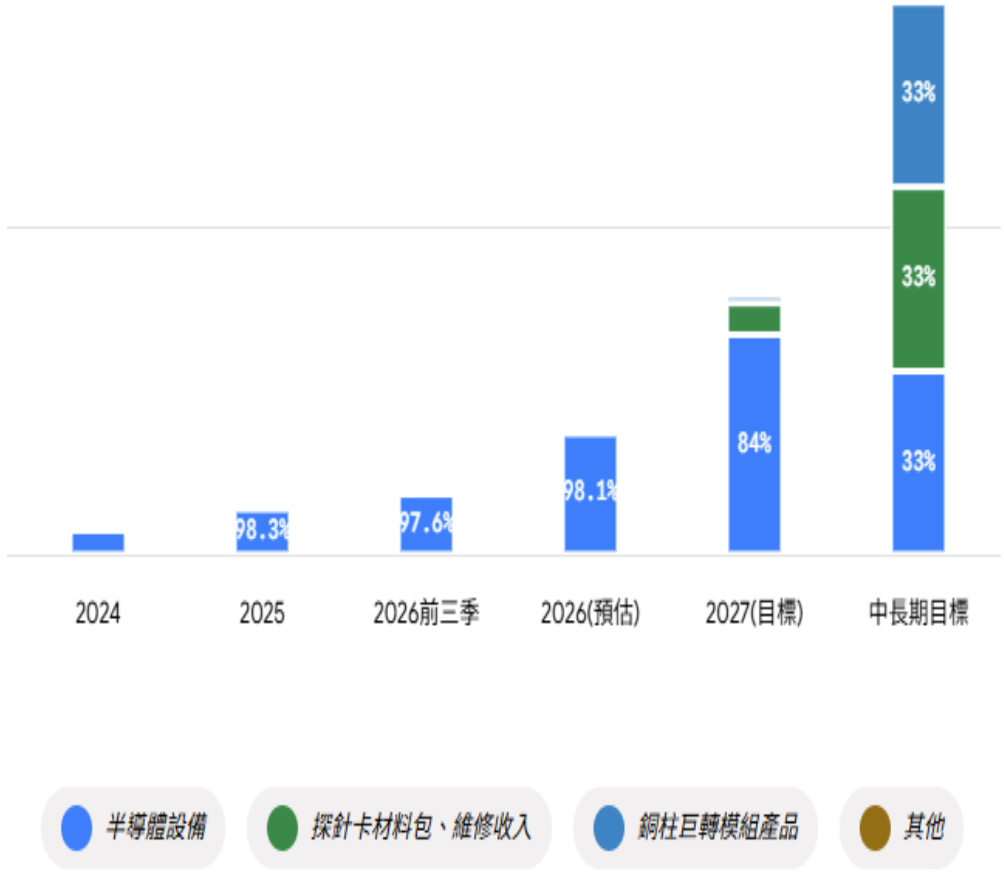
探針卡材料包及維修

- 新IC探針卡案，陸續導入 MEMS探針並提供後續維修服務。
- 自動維修產線擴大產線，提供客戶快速高效返修服務，大幅縮減lead time。

銅柱巨轉模組

- 創新銅柱方案，專注Power 模 組 及 TGV CoWoS 封裝等市場。
- 2026底開始量產銅柱模組,應用於天線模組AiP、Power模組及穿戴式耳機通訊模組等。
- 2028年底目標量產TGV-ICP核心玻璃基板產品, 應用於高速傳輸晶片封裝。

各期營收結構與中長期目標



© Innostar Service Inc. Confidential & Proprietary.

THANK YOU For Your Attention